

скую форму; с увеличением размеров капли приобретают плоскую форму. Распределение капель по размерам описывается функцией типа

$$\Delta n = c D_k^\gamma,$$

$\Delta n$ ,  $D_k$  — количество и диаметр капель;  $c$ ,  $\gamma$  — постоянные, зависящие от давления газа в объеме и угловой координаты.

Проведенные исследования позволяют сделать выводы, что при эрозии микропятнами катодов с пористостью 8—10 % стационарной вакуумной дуги угол разлета микрокапельной фазы достигает 360° на поверхности катода. В парах порошкового катода с данной пористостью происходит частичная кристаллизация жидкой фазы, которая приводит к уменьшению количества микрокапель в объеме конденсата в 2 раза в сравнении с эрозией литьих катодов.

### Литература

- [1] Немчинский В. А. ЖТФ, 1979, т. 49, № 7, с. 1379—1384.
- [2] Мойжес Б. Я., Немчинский В. А. ЖТФ, 1984, т. 54, № 1, с. 13—18.
- [3] Аксенов И. И. и др. ЖТФ, 1984, т. 54, № 8, с. 1530—1534.
- [4] Мойжес Б. Я., Немчинский В. А. ЖТФ, 1980, т. 50, № 1, с. 78—86.
- [5] Еккер. В кн.: Вакуумные дуги. Теория и приложения. М.: Мир, 1982. 269 с.
- [6] Любимов Г. А., Раховский В. И. УФН, 1978, т. 125, № 4, с. 665—703.

Пермский политехнический институт  
Республиканский инженерно-технический  
центр порошковой металлургии

Поступило в Редакцию  
15 апреля 1987 г.  
В окончательной редакции  
8 февраля 1988 г.

УДК 537.311.331

Журнал технической физики, т. 58, в. 8, 1988

### НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ InSb, ПОДВЕРГНУТОГО ЛАЗЕРНОМУ ОТЖИГУ В СРЕДЕ ЖИДКОГО АЗОТА

Г. Г. Громов, А. Вернер, К. В. Руденко, В. А. Семенюк, В. Б. Уфимцев

Ранее в работе [1] сообщалось о наносекундном лазерном отжиге ( $\lambda = 1.064 \text{ мкм}$ ,  $t = 10 \text{ нм}$ ) антимонида индия в среде жидкого азота, приводящем к увеличению коэффициента отражения облученной поверхности  $R$  до 56 %. Причем в послеимпульсный период выдержки образцов в нормальных условиях происходила полная релаксация  $R$  до значения  $R_{\text{InSb}} = 46.2 \%$  ( $\lambda = 0.63 \text{ мкм}$ ). В ряде работ, например [2, 3], также наблюдался рост коэффициента отражения поверхности полупроводников (Si, GaAs, InP) после короткоимпульсного лазерного отжига, что было связано с аморфизацией поверхностного слоя.

По аналогии с данными работами можно предположить, что при лазерном отжиге InSb в жидком азоте также происходит структурное превращение. Однако ряд наблюдающихся особенностей высокоотражающей фазы на InSb (несвойственная для аморфного InSb нестабильность) требует проведения дальнейших исследований.

Для детального изучения особенностей релаксации высокоотражающей фазы в настоящей работе методика измерения динамики  $R$  [1] дополнена термостатированием образца в послеимпульсный период времени в инертной среде (Ar) при различных температурах для определения температурной зависимости скорости релаксации. Кроме того, исследовалось изменение удельной плотности в слое отожженного InSb, для чего применен метод профилометрии поверхности (профилометр TALYSTEP фирмы «TAYLOR—HOBSON» с высоким разрешением  $\sim 10 \text{ \AA}$ ). Изучались изменение профиля поверхности InSb, отожженного в жидком азоте при различных плотностях энергии лазерного воздействия, а также его динамика в послеимпульсный период в сопоставлении с релаксацией  $R$ . Для определения толщины поверхностной области, претерпевшей фазовое превращение, применялся метод селективного химического травления отожженного InSb до полного удаления высокоотражающей фазы, что контролировалось по изменению  $R$  (схема метода аналогична [4]) с последующей профилометрией.

Изучение релаксации высокоотражающей фазы при различных температурах термостатирования показало существенную температурную зависимость ее устойчивости. На рис. 1 представлена зависимость времени релаксации  $\tau_{\text{рел}}$  от температуры  $T$  в координатах  $\ln \tau_{\text{рел}} - T^{-1}$ . Интересным представляется тот факт, что экспериментальные значения (1) с достаточной точностью аппроксимируются линейной зависимостью (2). Известно, что такая зависимость характерна для термически активируемых процессов и позволяет вычислить энергию активации  $E_{\text{акт}}$ . Полученная в нашем случае величина  $E_{\text{акт}} = 1.48 \text{ эВ}$  (согласно данным рис. 1).

В связи с тем что структурные превращения сопровождаются изменением плотности  $\rho$  вещества, представляет интерес измерение величины данного эффекта в нашем случае. На рис. 2, а представлен профиль поверхности InSb, облученного в жидком азоте через маску в виде круглого отверстия, плотно прижимаемую к поверхности. Профили поверхности записывались сразу после отжига ( $P = 0.15 \text{ Дж/см}^2$ ). Как видно из рис. 2, а, в результате отжига происходит образование ступеньки на границе облученной и необлученной областей на величину до  $\Delta h = 100 \div 150 \text{ \AA}$  (кривизна линий необлученной поверхности и дна облученной области объясняется особенностью профилометра). В послеимпульсный период времени после полной релаксации коэффициента отражения наблюдалось соответствующее уменьшение  $\Delta h$  ступеньки

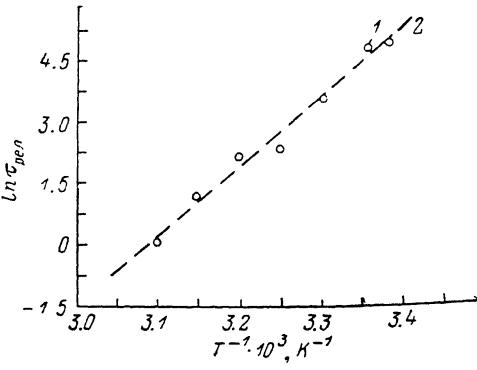


Рис. 1.

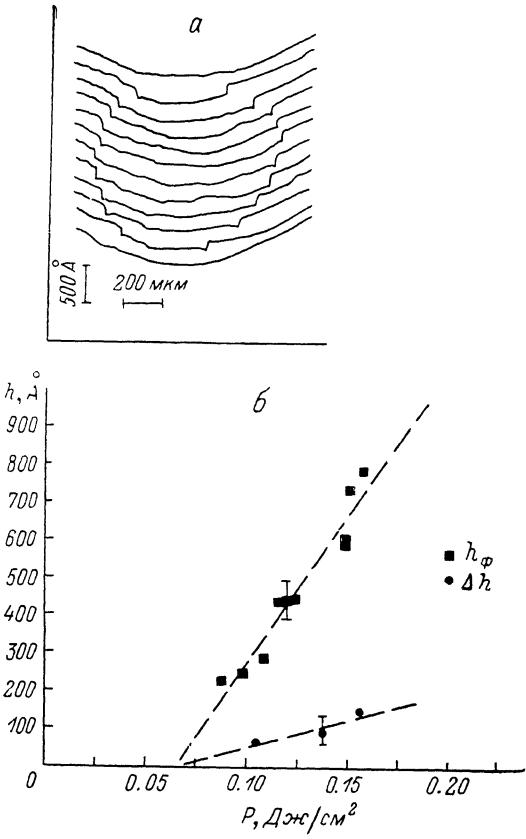


Рис. 2.

вплоть до восстановления планарности поверхности. Таким образом, имеет место обратимое изменение (увеличение) плотности  $\rho$  антимонида индия в результате отжига в среде жидкого азота.

На рис. 2, б представлена суммарная зависимость  $\Delta h$ , измеренной непосредственно после отжига, от плотности энергии  $P$  лазерного воздействия. Здесь же представлена зависимость толщины слоя высокоотражающей фазы  $h_\phi$ , измеренной по методу контролируемого травления последующей профилометрии. Сопоставляя величины  $\Delta h$  и  $h_\phi$  для фиксированной  $P$ , можно оценить величину скачка плотности  $\Delta \rho / \rho$  в результате фазового превращения  $\Delta \rho / \rho = \Delta h / h_\phi$ . Согласно данным рис. 2, б (с учетом погрешности методики),  $\Delta \rho / \rho = 19 \pm 3.5 \%$ . Если плотность исходного InSb составляет  $\rho_{\text{кр}} = 5.775 \text{ г/см}^3$ , то плотность слоя, претерпевшего фазовое превращение, должна, таким образом, составлять  $6.9 \pm 0.2 \text{ г/см}^3$ .

Сопоставление с известными данными по плотности фаз антимонида индия показывает, что измеренная в работе плотность высокоотражающей фазы существенно больше, чем у аморфного InSb ( $\rho_a = 5.3 \pm 0.5 \text{ г/см}^3$  [5]). Причем в случае образования аморфного слоя не должно было бы наблюдаться ступеньки на границе облученной и необлученной областей (рис. 2, а), так как  $\rho_a \ll \rho_{\text{кр}}$ .

С другой стороны, плотность образующейся высокоотражающей фазы близка к плотности металлических фаз антимонида индия ( $\rho_{\text{ромб}} = 7.25$ ,  $\rho_{(\beta-\text{Sn})} = 6.92$ ,  $\rho_{(\text{NaCl})} = 6.85 \text{ г/см}^3$  [6]).

Более того, отдельные металлические фазы антимонида индия проявляют метастабильную устойчивость вплоть до комнатных температур ( $T=288$  К [7]), что хорошо согласуется с установленной температурной устойчивостью высокоотражающей фазы, образующейся при лазерном отжиге в жидком азоте (рис. 1).

В заключение следует отметить, что эффекта образования высокоотражающей фазы в отличие от случая жидкого азота не наблюдалось при аналогичных параметрах наносекундного отжига InSb в нормальных условиях ( $T=298$  К), а также при увеличении длительности импульса до 100 нс и более (70 мкс) в среде жидкого азота.

## Литература

- [1] Громов Г. Г., Руденко К. В., Уфимцев В. Б. ЖТФ, 1986, т. 56, № 10, с. 1998—2000.
- [2] Алферов Ж. И., Арутюнов Е. Н., Васильев А. Н. и др. Письма в ЖТФ, 1985, т. 14, № 15, с. 916—920.
- [3] Liu P. L., Yen R., Bloembergen N., Hodgson R. T. Appl. Phys. Lett., 1979, v. 34, N 12, p. 864—866.
- [4] Громов Г. Г., Давыдов А. В., Уфимцев В. Б. Электронная техника. Материалы, 1982, № 11, с. 62—64.
- [5] Stuke J., Zummerer G. Phys. Stat. Solidi (B), 1972, v. 49, N 513, p. 513—523.
- [6] Петросян В. И., Васин О. И., Стенчин С. И. и др. Письма в ЖЭТФ, 1977, т. 26, № 1, с. 10—13.
- [7] Дегтярёва В. Ф., Белаши И. Т., Чипенко Г. В. и др. ФТТ, 1983, т. 25, № 10, с. 2968—2974.

Московский институт  
тонкой химической технологии  
им. М. В. Ломоносова

Поступило в Редакцию  
25 мая 1987 г.

УДК 537.811.33

Журнал технической физики, т. 58, в. 8, 1988

## НЕРАВНОВЕСНАЯ ГРАДИЕНТНО-ЗОННАЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ (НГЗК) В ПОЛУПРОВОДНИКЕ

Б. С. Евсеев

В последнее время большое развитие получили исследования разновидностей зонной плавки (криSTALLизации), впервые обнаруженной и рассмотренной Пфанном [1, 2], в том числе зонной перекристаллизации градиентом температуры [3], электроЖидкостной эпитаксии [4, 5], электромиграции расплавленных зон на поверхности и в объеме полупроводника [6] и др. Общей особенностью этих процессов является сравнительно большая протяженность зон в направлении их движения (минимальные протяженности превышают десятки микрометров) и малая скорость их движения (скорости движения минимальных зон обычно не превышают  $10^{-4}$  см/с). Это позволяет вполне корректно описывать эти процессы (как стационарные, так и нестационарные) в рамках классической (равновесной) термодинамики.

В настоящей работе представлена теория НГЗК в полупроводнике. В основе НГЗК лежит процесс формирования мобильного жидкокристаллического домена (ЖКД) в твердофазной области (ТФО) и транспорт его через полупроводник. Формирование ЖКД при НГЗК происходит известным способом [7—9] и аналогично формированию неравновесной электронной системы при лазерно-инжециционном отжиге (ЛИО) [10—12], а именно путем последовательного поглощения коротковолнового ( $\hbar\omega > E_g$ ) и длинноволнового ( $\hbar\omega < E_g$ ) лазерных излучений. Транспорт ЖКД через полупроводник осуществляется электрическим полем, возбуждаемым в структуре ТФО—ЖКД—ТФО электронным и ионным зондами, аналогично транспорту фотогенерированных носителей при ЛИО в продольном электрическом поле [12]. Поток излучения  $I_1$  ( $\hbar\omega > E_g$ ) формирует на одной стороне полупроводникового кристалла жидкую fazу. Со стороны другой поверхности полупроводник облучается потоком излучения  $I_0$  ( $\hbar\omega < E_g$ ), для которого кристалл почти прозрачен. Поток  $I_0$  поглощается в жидкой fazе на некоторой глубине, которая и определяет начальную протяженность ЖКД вдоль направления оптического волнового вектора. Область ЖКД, везде, за исключением границ, электронейтральна и имеет структуру электронного расплава (в моногатомных полупровод-